

珠海市半导体行业协会

珠半协秘（2024）3号

关于征集 2024 年集成电路产业年会“芯”品发布会企业产品的通知

各企业：

为进一步促进我市集成电路产业的发展，为企业搭建市场推广平台，加强产业链上下游的合作，促进新技术、新产品的推广应用，协会将在“2024 珠海软件和集成电路产业年会暨产业高质量发展论坛（集成电路产业专场）”上举办企业新产品发布会及相关推广活动，帮助企业宣传优秀新品，现面向珠海集成电路企业公开征集优秀产品及解决方案。具体内容如下：

一、会议时间和地点：

时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 16: 20-17: 50

地点：珠海新骏景万豪酒店三楼（宴会厅）

二、征集范围：

集成电路设计产品，包括但不限于计算芯片（含 AI 芯片）存储芯片、多媒体芯片、通信芯片、功率芯片、传感器等，及

EDA 工具和 IP 产品等。

三、发布企业数量、发布形式

通过公开征集，最终遴选 8 家企业，在新产品发布会上进行宣讲。多方位帮企业提升新品市场认知度、增强品牌影响力。

四、入选企业回馈

1、入选企业将获得 8 分钟的现场产品发布时段，同时通过线上直播平台进行宣传；

2、企业宣传资料在《年会会刊》中获得 1 个 A4 页面的广告位和 1 个年会嘉宾席位。

五、费用：

会员单位及特邀企业：免费

非会员单位：5000 元/家

户 名：珠海市半导体行业协会

开户行：中国建设银行珠海唐家支行

账 号：44050164933500001031

（如需专票，请附上开票信息，开票内容：服务费）

六、报名方式：

席位有限，先报先得，最终参与名单由会议主办方确定。请有意愿参加的企业于 2023 年 4 月 16 日前发送附件表格至 member@zhsia.org.cn。

联系人：会员服务部，马岫，17377872077

附件：企业“芯”产品发布会产品征集登记表

珠海市半导体行业协会
2023年4月10日

